



深圳骏广电子材料有限公司

JX日矿金属高机能铜合金专业代理商

[Http://www.jungunemc.com](http://www.jungunemc.com)

电话: (86) 0755-2698 0389

邮箱: sale@jungunemc.com

FPC用压延铜箔 (GHY5处理箔)

Rolled Copper Foil for Flexible Printed Circuit(GHY5 Treatment Foil)

- 新规压延铜箔(GHY5处理箔)和现行的标准压延铜箔(Y处理箔)相比，实现了粗化粒子的超细微化、箔表面的超低粗度

New RA copper foil (GHY5 Treatment Foil) has super fine nodules and the lowest surface roughness compared with that of regular Y Treatment RA Foil

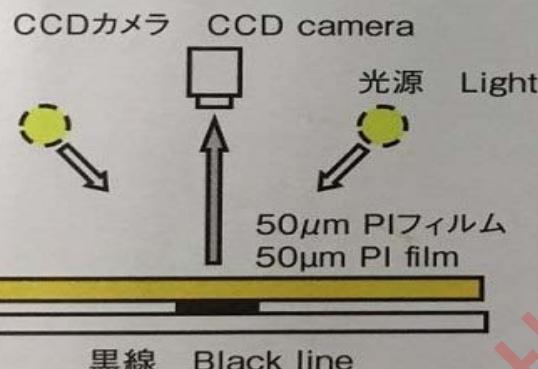
- FFCL的铜箔蚀刻除去后，实现PI(聚酰亚胺)膜基板的高透明性。

With this new RA foil, excellent PI (polyimide) film transparency can be obtained after removal of copper foil etching of FCCL.

- 多层基板的FPC位置准线工序中发挥优异可清晰可视效果。

Superior Visibility performance can be achieved for alignment process for multi-layer FPC.

CCDカメラによるPIの視認性評価 Evaluation of PI visibility by CCD camera



JX 新規压延銅箔
JX new RA foil

境界が明瞭
Clear image
高コントラスト
High contrast

他社銅箔
Competitor

境界が不明瞭
Not clear
肩部
Shoulder

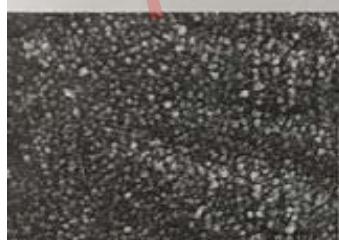
50μmポリイミドフィルムを使用した両面FCCLの銅箔層を溶解した後のポリイミドフィルムにおけるCCDカメラでの画像認識評価結果(JX-New RA foil vs. other)

Visibility test result of measurement by CCD camera of PI film after etching of copper foil of D/S FCCL that used 50μm PI film.

粗化処理後の銅箔表面

Copper foil surface
after roughing treatment

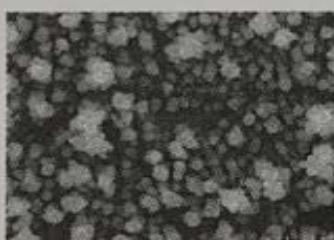
GHY5処理箔
GHY5 Treatment Foil



表面粗さ

Surface roughness
Rz : 0.40μm

通常压延銅箔
(Y處理)
Regular RA Foil
(Y Treatment)



表面粗さ

Surface roughness
Rz : 0.80μm

銅箔エッチング後のPIフィルム透明性

PI film transparency
after copper foil etching.

(a) GHY5処理箔を使用
したFCCLのPIフィ
ルム
PI film of FCCL
using GHY5 foil

(b) 他社銅箔を使用した
FCCLのPIフィルム
PI film of FCCL
using competitor's
foil

